

10月31日(木)10:00-12:30	コース	10月31日(木)14:00-16:40	11月1日(金)12:50-15:05	11月1日(金)15:35-17:50
KM-1 挨拶・基調講演 10:00-12:30 (受付・ウエルカムコーヒー 9:30 開始)	【A】次世代自動車	A-1 自動運転/コネクテッドカー実現の最前線 松浦正純(ルネサス)/山崎治(シャープFITオートモーティブ)	A-2 モビリティ進化を支える革新的キーデバイス 松浦正純(ルネサス)/山崎治(シャープFITオートモーティブ)	A-3 次世代車載パワーデバイス 石田昌宏(パナソニック)/佐藤高史(京都大学)
司会:中村 孝(大阪大学) ◆来賓挨拶 京都府副知事 山下 晃正 京都市長 門川 大作		<ul style="list-style-type: none"> ◆自動運転の商業化 ㈱ZMP 代表取締役社長 谷口 恒 ◆自動車データを活用したサービス 本田技研工業㈱ 経営企画統括部 ビジネス開発部 ビジネス開発課 主任 福森 穂 ◆次世代自動車の世界市場展望～CASE戦略とイノベーションの動向～ カノラマジヤパン㈱ 代表取締役 宮尾 健 	<ul style="list-style-type: none"> ◆駐車支援/自動駐車システムのビューカメラ・イメージセンサの市場展望 ㈱矢野経済研究所 自動車産業グループ マネージャー 主任 池山 智也 ◆車載向け距離画像センシング技術の進展 パナソニック㈱ イングストリアルソリューションズ社 技術本部・センシングソリューション開発センター 部長 小田川 明弘 ◆CMOS Image Sensor Packaging Technology for Automotive Applications UTAC Group Chief Technology Officer Il Kwon Shim 	<ul style="list-style-type: none"> ◆シリコンからSiCパワー半導体デバイスの最新技術動向 筑波大学 数理物質系 物理工学領域 教授 岩室 憲幸 ◆車の電動化・知能化に向けた実証技術動向と課題 日産自動車㈱ 電子技術・システム技術開発本部/エキスパートリーダー 堀井 良和 ◆SiC MOSFETとIGBT使い分け インフィニオンテクノロジーズジャパン㈱ イングストリアルパワーコントロール事業本部 マーケティング&アプリケーションサポート部 ビジネスデベロップメント&マーケティングマネージャー 藤森 正然
◆基調講演「HPC(High Performance Computing)活用によるパナソニックのデジタルイノベーション」 パナソニック㈱ テクノロジーイノベーション本部 HPCプロモーションセンター 所長 宮嶋 浩志 ◆基調講演「Society 5.0を支えるMRAMベース AIアプリケーションプロセッサの最前線」 東北大学 国際集積エレクトロニクス研究開発センター センター長 遠藤 哲郎 ◆基調講演「世界経済/政治の激動が続く中でニッポン電子デバイスはどう戦うのか」 ㈱産業タイムズ社 代表取締役社長 泉谷 渉	【B】5G・AI・センシング	B-1 5Gの最前線 加藤千晴(村田製作所)/岡田吉生(GF)	B-2 AI向けデバイス 岡田吉生(GF)/石田昌宏(パナソニック)	B-3 次世代センシング 泉谷渉(産業タイムズ社)/重松智志(NTTエレクトロニクス)/佐々木元(メガテックス)
11月1日(金)9:30-11:55 KM-2 マーケティングセッション 9:30-11:55 (受付 9:00 開始)	【C】最先端半導体飛躍の時	C-1 世界をリードする日本の半導体材料技術 酒井滋樹(日新イオン機器)/藤原健典(東レ)	C-2 進化を続ける半導体プロセス・装置技術 森義弘(SCREEN)/廣田良浩(東京エレクトロ)	C-3 5G・AI・IoT時代を支える半導体デバイス・回路技術 廣田良浩(東京エレクトロ)/三番士道彦(ローム)/山本浩之(マイクロモザイク)
司会:松下晋司(㈱産業タイムズ社) ◆特別講演「市況減速に直面する半導体デバイスと製造装置、電子部品市場の現状と今後の展望」 ㈱産業タイムズ社 大阪支局 電子デバイス産業新聞 編集部 記者 中村 剛 ◆特別講演「IoT時代で変わる生活とエレクトロニクス産業～EV・IoT・AIが半導体産業を牽引する～」 IHS Markit TMT Japan Research Director 南川 明		<ul style="list-style-type: none"> ◆EUVリソグラフィとマスク技術の動向 大日本印刷㈱ ファインオプトロニクス事業部 フェロー 林 直也 ◆レジスト材料とEUVリソグラフィ技術の最新動向 富士フイルム㈱ R&D統括本部 エレクトロニクスマテリアルズ研究所 マネージャー 藤森 亨 ◆シリコン基板をベースとした次世代パワーデバイスおよびイメージセンサ向け真空常温接合ウエーハの検討 ㈱SUMCO 評価・基盤技術部 製品基盤技術課 担当課長 古賀 祥泰 	<ul style="list-style-type: none"> ◆EUVパターニング技術と課題 東京エレクトロ九州㈱ 開発本部 プロセス技術部 ブルーリーダー 村松 誠 ◆最先端半導体製造を支える最新洗浄技術 ～先端ロジック/メモリからパワーデバイスまで～ ㈱SCREENセレクトロニクスソリューションズ CGS製品統轄部 洗浄技術開発部 部長 高橋 弘明 ◆Specialty Markets & More-than-Moore(MtM) Technologies Applied Materials INC, Group Vice President, General Manager, ICAPS Groups Sundar Ramamurthy 	<ul style="list-style-type: none"> ◆Spin-Orbitronicsを応用した新型MRAMの紹介 SPIN-ORBITRONICS TECHNOLOGIES㈱ CEO & CTO 興田 博明 ◆DRAM & Emerging Memory Technology: Process and Materials Techinsight Inc. Technology Intelligence/Senior Technical Fellow Jeongdong Choo ◆アナログ技術の粋を集めた革新的電源IC「Nano Series」の紹介 ローム㈱ LSI開発本部 回路技術開発部 先行電源技術開発課 統括係長 山口 雄平
◆特別講演「フラットパネルディスプレイ業界:最終決戦～」 みずほ証券㈱ エキイティ調査部 グローバル・ヘッド・オブ・テクノロジー・リサーチ/シニアアナリスト 中根 康夫	【D】特別セッション①	D-1 大学セッション(無料) ナノテクノロジープラットフォーム 戸所義博(イーセップ)/向井雅昭(京都工芸繊維大学)	D-2 パッケージング市場動向と最新技術動向(5G/μLED) 藤原健典(東レ)/不破保博(ローム)	D-3 最新FOパッケージング・材料・装置関連 森川泰宏(ULVAC)/酒井滋樹(日新イオン機器)
11月1日(金)15:35-17:50 ◆特別講演「IoT時代で変わる生活とエレクトロニクス産業～EV・IoT・AIが半導体産業を牽引する～」 IHS Markit TMT Japan Research Director 南川 明	【E】特別セッション②	E-1 機器分解による電子部品市場の解析 木村匡雄(ソニー)/中村孝(大阪大学)	E-2 米中貿易競争下の中国半導体動向 戸所義博(イーセップ)/神原弘之(ASTEM)	E-3 先進半導体によるがん治療・診断革命 松下晋司(産業タイムズ社)/中村孝(大阪大学)
		<ul style="list-style-type: none"> ◆分解解析から見る注目のミリ波使用電子機器 セミコンサルト 代表 上田 弘孝 ◆米Tesla社のModel Sを構成する電子デバイス 展示アテンドも実施 ㈱村田製作所 技術・事業開発本部 共通基盤技術センター 企画管理課 シニアマネージャー 興膳 義明 	<ul style="list-style-type: none"> ◆中国半導体の方向性と展望 ㈱産業タイムズ社 上海支局長 黒典 典善 ◆日米中韓の貿易摩擦の行方 (一財)日中経済協会 専務理事 東京工業大学 環境・社会工学学院 CBECプログラム 特任教授 杉田 定大 	<ul style="list-style-type: none"> ◆シリコン光電子増倍素子(SIPM)を用いたPET診断装置 浜松ホトニクス㈱ 中央研究所 第5研究室 副研究員 大村 知秀 ◆SiCパワーデバイスを用いた革新的BNCTがん治療装置の開発 福島SiC応用技術㈱ 代表取締役 CEO 古久保 雄二 ◆Metallo-balance 血液中の微量元素分析によりがんリスク・スクリーニングをおこなう方法 ㈱レナテック 最高顧問 稲垣 精一